

中信证券股份有限公司
关于上海灿瑞科技股份有限公司
2022 年度持续督导跟踪报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“灿瑞科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责灿瑞科技上市后的持续督导工作，并出具本年度持续督导跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作计划制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与灿瑞科技签订保荐及承销协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2022 年度灿瑞科技在持续督导期间未发生按有关规定必须保荐机构公开发表声明的违法违规情况
4	持续督导期间上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当自发现之日起五个工作日内，向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐人采取的督导措施等	2022 年度灿瑞科技在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等事项
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式，了解灿瑞科技经营情况，对灿瑞科技开展了持续督导工作
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺	2022 年度，保荐机构督导灿瑞科技及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所做出的各

序号	工作内容	实施情况
		项承诺
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促灿瑞科技依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对灿瑞科技的内控制度的实施和有效性进行了核查，截至本持续督导跟踪报告出具之日，灿瑞科技的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运行
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促灿瑞科技严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充，公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告；对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对灿瑞科技的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项
11	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	灿瑞科技及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未发生该等事项
12	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告	灿瑞科技及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况
13	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的问题事项
14	发现以下情形之一的，督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反	2022年度，灿瑞科技未发生相关情况

序号	工作内容	实施情况
	《上市规则》等相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十一条、第七十二条规定的情形；（四）公司不配合持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形	
15	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查质量。	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求
16	上市公司出现以下情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日 15 日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人、董事、监事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（三）可能存在重大违规担保；（四）资金往来或者现金流存在重大异常；（五）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项	2022 年度，灿瑞科技不存在需要专项现场检查的情形

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

2022 年度，保荐机构和保荐代表人未发现灿瑞科技存在重大问题。

三、重大风险事项

公司目前面临的风险因素主要如下：

（一）新产品研发及技术迭代的风险

集成电路行业属于技术密集行业，下游应用领域广泛，其中智能手机、平板电脑等消费电子领域的更新换代较快，集成电路产品需紧跟下游应用领域的变化进行产品创新与升级，公司经过多年对智能传感器芯片、电源管理芯片等产品的研发，已积累了一批核心技术，并在行业内具备较强的竞争优势。但随着终端客户对产品技术及应用需求的不断提高，行业中新技术、新产品及新方案不断涌现，公司需要持续进行研发投入和技术创新，不断更新现有产品品类并研发新技术和新方案，保持核心技术的先进性和主营产品的竞争力。

如果公司未来不能保持持续的创新能力，不能准确把握行业、技术的发展方向，导致新产品研发进度和技术迭代周期无法匹配行业发展和客户需求的变化，将使公司无法在市场竞争中占据优势地位，并给公司未来业务拓展和经营业绩带

来不利影响。

（二）核心技术泄密风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司自主研发了一系列具有自主知识产权的核心技术，并形成较完善的技术体系。为保护自身的核心技术，公司制定了严格的保密措施，与核心技术人员及研发骨干签署了保密协议，并通过申请专利、集成电路布图设计、计算机软件著作权等方式进行产权保护。同时，公司尚有多项产品和技术解决方案正处于研发阶段，公司在新产品产业化过程中需要和产业链上游厂商紧密合作，如果未来核心技术人员流失或者在生产经营过程中相关技术、数据、图纸等保密信息泄露，可能存在核心技术泄密或被外界盗用的风险，从而对公司保持核心竞争力造成不利影响。

（三）技术人员流失的风险

集成电路行业是典型的知识和技术密集型行业，对研发人员的半导体物理学、半导体材料学、微电子与系统学、信息学等学科的理论基础以及从业经验有较为严格的要求，优秀的技术人员需要精通半导体电路设计、工艺开发、集成电路验证与测试等多项技术，且经过较长时间的技术积淀才可参与或主导相关产品的研发与设计。国内集成电路企业经过多年的技术沉淀，已经积累了一批人才，但与国际领先集成电路厂商相比，高端专业人才仍相对稀缺，由于国内集成电路企业发展迅速，人才竞争也日趋激烈。

公司目前已建立了一支多层次、高素质、经验丰富的研发技术团队，且形成了良好的薪酬与激励机制，但如果随着未来市场竞争的加剧，公司不能继续保持对技术人员在薪酬水平、激励机制方面的吸引力，将存在技术人员流失的风险，对公司保持竞争力和业务的持续发展造成不利影响。

（四）经营业绩可能无法持续高速增长的风险

公司主要产品及服务包括智能传感器芯片、电源管理芯片及封装测试服务，最近三年受益于下游领域需求的快速增长，公司经营规模得以快速提升。

但随着当前国际贸易摩擦的升级，下游领域的发展面临着复杂和严峻局面，存在一定的不确定因素，在此背景下，若宏观经济环境发生重大变化、经济增速放缓，导致智能家居、智能手机、计算机、可穿戴设备等下游领域的发展放缓，或者公司无法准确把握下游需求的变化和行业发展趋势，导致对下游领域的拓展

和渗透不及预期，可能导致公司经营业绩高速增长的趋势无法持续，公司未来可能面临业绩增速放缓的风险。

（五）市场竞争加剧且市场占有率难以快速提升的风险

公司所在的高性能集成电路行业正经历快速发展，广阔的市场空间吸引了诸多国内外企业进入这一领域，行业内厂商在巩固自身优势基础上积极进行技术研发和市场拓展，行业竞争有加剧的趋势。目前公司所处行业主要由欧美、日韩等国际领先企业主导，公司在智能传感器芯片和电源管理芯片领域的市场占有率与同行业国际领先企业相比仍存在一定差距。

如果公司不能正确把握市场发展机遇和行业发展趋势，不能适应激烈的竞争环境并保持产品的高品质和供货的稳定性，或者不能保持行业内的技术领先，则可能导致在市场竞争中处于不利地位，且市场占有率难以快速提升。

（六）毛利率存在可能无法持续增长的风险

公司正处于业务快速发展的阶段，毛利率主要受下游市场需求、产品售价、产品结构、原材料及封装测试成本、公司技术水平等多种因素影响。若上述因素发生持续不利变化，公司毛利率存在可能无法持续增长甚至出现下滑的风险，从而影响公司的盈利能力及业绩表现。

（七）应收账款回收的风险

随着公司经营规模的扩大，应收账款余额可能进一步增加，较高的应收账款余额会影响公司的资金周转效率、限制公司业务的快速发展。如果公司采取的收款措施不力或上述客户经营状况发生不利变化，则公司应收账款发生坏账风险的可能性将会增加。

四、重大违规事项

2022年，公司不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

（一）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2022年	2021年	本期比上年同期增减（%）
营业收入	593,201,183.14	537,194,301.17	10.43

归属于上市公司股东的净利润	135,042,424.99	125,001,562.30	8.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	121,864,927.19	111,415,552.09	9.38
经营活动产生的现金流量净额	22,611,693.73	75,564,558.96	-70.08
	2022 年末	2021 年末	本期比上年同期增 减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,572,091,961.67	436,383,314.68	489.41
总资产	2,718,030,450.73	622,933,748.89	336.33

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2022 年	2021 年	本期比上年同期增 减 (%)
基本每股收益 (元 / 股)	2.21	2.16	2.31
稀释每股收益 (元 / 股)	2.21	2.16	2.31
扣除非经常性损益后的基本 每股收益 (元 / 股)	2.00	1.93	3.63
加权平均净资产收益率 (%)	16.12	33.48	减少 17.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率 (%)	14.54	29.85	减少 15.31 个百分点
研发投入占营业收入的比例 (%)	13.83	10.71	增加 3.12 个百分点

(三) 主要会计数据和财务指标的说明

2022年度营业收入同比增长10.43%，主要系公司2022年灵活调整业务布局，延伸汽车电子、工业控制等终端应用场景，同时努力巩固及维持已有消费电子业务份额，积极拓展新客户，实现了业务规模的持续增长；

2022年度经营活动产生的现金流量净额下降70.08%，主要系行业和外部环境的影响，进而对公司回款进度产生影响；

2022年归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别同比增长8.03%、9.08%，主要系2022年度营业利润增加所致；

基本每股收益、稀释每股收益及扣除非经常性损益后的基本每股收益分别同

比增长 2.31%、2.31%及 3.63%，主要系 2022 年度营业收入上升，净利润增加、盈利能力提升所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）核心竞争力分析

1、出色的研发能力，产品核心技术处于领先水平

研发能力和技术水平是集成电路企业的重要核心竞争力。公司一贯重视技术研发，经过多年的研发投入和技术积累，在智能传感器芯片和电源管理芯片的研发设计、封装测试领域积累了丰富的研发经验。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已取得内地专利 74 项（其中发明专利 27 项），港澳台及境外专利 16 项（其中发明专利 12 项），集成电路布图设计专有权 80 项，软件著作权 7 项，形成完整的自主知识产权体系。公司“高性能磁传感器系统及芯片关键技术的研发和应用”课题于 2020 年荣获上海市科技进步奖二等奖；同年，公司入选工业和信息化部发布的《第二批专精特新“小巨人”企业名单》。此外，公司“双极锁存型霍尔开关电路”、“非隔离准谐振降压 LED 恒流驱动器”、“数字 I2C 通讯接口 LCD 屏幕偏压驱动器”、“数字一线通讯接口双路大电流 LED 闪光驱动器”和“H 桥电机驱动器”产品为上海市高新技术转化项目，并建立院士专家工作站。

在智能传感器芯片领域，公司基于“嵌入式集成磁传感器智能 H 桥驱动电路设计技术”、“基于主动式虚通道可编程参数配置的磁传感系统芯片架构技术”、“低功耗 CMOS 传感器信号处理技术”等核心技术，形成超过 400 款智能传感器芯片产品，完成了高可靠性、高精度、低噪声、超低功耗、集成化等关键技术突破，主要产品的技术性能达到国际先进水平，可以与国际知名磁传感器芯片厂商的同类产品竞争。同时，公司紧跟光传感器芯片的前沿研发方向，把握结构光技术和 TOF 技术下光源芯片的发展趋势，成功研发出符合市场需求的 IR 和 VCSEL 发射器及驱动芯片，且已应用于智能安防和人脸支付领域知名厂商的产品中。

在电源管理芯片领域，公司积累了“高精度低纹波电流输出直流转换电源电路设计技术”、“宽幅高线性调光控制技术”、“自适应高精度恒定电流控制技术”等核心技术，形成超过 150 款电源管理芯片产品，在低功耗、过压过流过温保护、输出效率等方面建立了自身的技术优势。

此外，公司紧跟智能传感器芯片和电源管理芯片行业的科技前沿，基于核心

技术不断丰富技术储备，在包括 OLED 屏幕偏压驱动、3D TOF VCSEL 传感芯片及 3D 磁传感器等多个智能传感器芯片和电源管理芯片前沿应用领域实现了技术突破。

2、建立“Fabless+封装测试”业务模式，通过产业链协同为公司可持续发展赋能

在“Fabless+封装测试”的经营模式下，公司建设自有封装测试生产线，在研发、生产、质量方面与自身研发设计形成了显著的协同效应，具体情况如下：

① 研发协同

芯片研发是一个多次迭代循环的过程，需要经过反复的仿真、流片、封装测试、设计修改等过程，直至产品性能指标和可靠性达到设计要求。一款成熟芯片的开发可能需要进行多次流片、封装测试，由于涉及到晶圆厂及封装测试厂，时间周期及灵活度均存在一定不确定性。公司拥有自有封测产线，能够协同提升研发效率：其一公司自主研发了快速封装平台，能够根据新产品特点对封测设备、模具等进行灵活、快速调整，加快对新产品的验证和测试，缩短新产品研发周期，提升新产品上市速度；其二通过深度参与芯片封测，公司能够在设计阶段充分评估封装策略以及封装对芯片应力等多项参数的影响，优化芯片设计方案，提升研发效率以及最终成品性能的高可靠性；其三公司在产品研发成功后就可立即转入批量生产阶段，实现研发、工程验证、批量生产的无缝衔接。

② 生产协同

公司拥有全流程封装测试服务能力，涵盖晶圆测试、芯片封装、成品测试等环节，能够大幅减少产品工艺流转、提升生产效率、缩短交付期限，尤其在上游封测产能紧张时，公司能够优先保证自研产品的生产，确保产品如期交付；公司能够根据产品特点布局生产工艺和产线，确保生产效率和产品质量，并且能够根据产品特点和客户需求对封测设备进行调校和改进，尤其是晶圆测试和成品测试环节，公司通过自主研发的测试程序和测试设备结合，能更好地满足定制化生产工艺和标准的要求，同时提高测试效率、降低成本。

③ 质量协同

采用 Fabless 模式的集成电路设计企业只从事集成电路的研发设计和销售，晶圆制造和封测完全依靠晶圆代工厂商和封测厂商的标准工艺，芯片的良品率和

性能受供应商标准工艺的限制。公司经过长期研发积累，已形成“高可靠性封装技术”、“精准磁通量测试技术”等核心技术，能够根据自研产品的特点进行晶圆测试、封装、成品测试工艺流程的调整，提高产品良率和可靠性。以磁传感器芯片为例，为减小外部环境在封装过程中引入的磁场误差，公司对封装测试设备进行无磁化的定制改造，进一步确保磁传感器芯片性能的稳定性和可靠性。

3、良好的品牌美誉度，核心产品覆盖不同领域的知名客户

公司是“上海市专精特新中小企业”、“上海市科技小巨人企业”、“上海市专利试点企业”，并进入工信部第二批专精特新“小巨人”企业名单。同时，公司凭借自身优异的产品性能和可靠的产品质量，核心产品覆盖了多产业链的知名客户。其中，智能传感器芯片在功耗、精度及可靠性等技术性能方面均表现优异并获得客户的认可，广泛应用于知名大小家电、数码消费品牌产品中；在电源管理芯片方面，公司凭借优良的电流精度、带载能力、输出效率奠定了电源管理产品的行业市场地位，产品已广泛应用于行业知名品牌手机、笔记本等数码消费电子产品中。

4、产品种类丰富，能够满足不同领域不同客户的多样化需求

公司的产品种类丰富，包括智能传感器芯片和电源管理芯片两大板块、六大系列、600余款产品型号，可满足智能家居、智能手机、计算机和可穿戴设备等不同领域终端客户在不同使用场景的应用需求。

在智能传感器芯片领域，公司产品参数类别和下游应用领域较为广泛，其中磁传感器芯片感应灵敏度参数覆盖5GS至200GS范围，驱动电压参数也适配12V、24V和36V等电机马达工作电压环境，此外，主要终端使用场景已逐步扩充至智能手机、扫地机器人、水气表、散热风扇、TWS耳机、平板电脑、智能电视和人脸识别智能支付终端等技术附加值高的应用领域；在电源管理芯片方面，公司立足核心产品屏幕偏压驱动芯片、闪光背光驱动芯片，持续跟踪终端客户需求，产品适用的终端产品类型丰富；同时，公司不断进行技术研发和新产品储备，形成MIPI开关芯片、TypeC转换接口芯片等产品。公司丰富的产品线能够满足下游客户尤其是大型电子设备制造厂商的多样化需求。

（二）报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

不适用。

七、研发总体情况及研发进展

（一）研发投入情况

2022 年，公司研发投入具体如下：

单位：元

项目	本年度	上年度	变化幅度（%）
费用化研发投入	82,018,741.73	57,546,165.83	42.53
资本化研发投入	-	-	-
研发投入合计	82,018,741.73	57,546,165.83	42.53
研发投入总额占营业收入比例（%）	13.83	10.71	3.11
研发投入资本化的比重（%）	-	-	-

（二）研发进展

公司 2022 年度各项在研项目正常开展，取得了一定的研发成果。2022 年度，公司新增实用新型专利 11 项，新增集成电路布图设计专有权 25 项。截至 2022 年 12 月 31 日，公司已取得内地专利 74 项（其中发明专利 27 项），港澳台及境外专利 16 项（其中发明专利 12 项），集成电路布图设计专有权 80 项，软件著作权 7 项，形成完整的自主知识产权体系。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1550 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2022 年 10 月 18 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,927.68 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 112.69 元。截至 2022 年 10 月 13 日止，公司共募集资金 2,172,302,592.00 元，扣除发行费用 172,326,590.53 元，募集资金净额 1,999,976,001.47 元。截止 2022 年 10 月 13 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（大华验字[2022]000678 号）。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 453,461,597.91 元。

本年度使用募集资金 453,461,597.91 元，收到存款利息扣除手续费后的净额 1,790,218.20 元，理财产品收益 4,753,037.60 元。截止 2022 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,553,057,659.36 元。

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司 上海市闸北支行	455983337282	2,025,191,332.20	223,480,473.20	活期
中国工商银行股份有限公司 上海市外滩支行	1001262119204694340			活期
交通银行上海分行徐汇 支行	31006617901300593842 0		364,375,852.93	活期
上海银行股份有限公司 市北分行	03005039982			活期
中信银行股份有限公司 上海分行	8110201013801502001		290,166,294.02	活期
嘉兴银行股份有限公司 科技支行	8010800366666			活期
中国银行上海市闸北支 行	450783649068		224,546,150.07	活期
中信银行股份有限公司 上海分行	8110201014501502008		475,704,219.87	活期
合计	—	2,025,191,332.20	1,578,272,990.09	

（二）募集资金使用是否合规

灿瑞科技 2022 年度募集资金存放与使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，灿瑞科技对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

名称	职务	持股情况	减持情况	质押或冻结情况
景阳投资	控股股东	直接持有灿瑞科技 34,891,465 股	无减持	无质押或冻结

名称	职务	持股情况	减持情况	质押或冻结情况
罗立权	董事长、实际控制人	直接持股 2,000,000 股；通过景阳投资间接持有公司 25.34% 股权；通过上海骁微间接持有公司 6.42% 股权；通过上海群微间接持有公司 4.69% 股权	无减持	无质押或冻结
罗杰	董事、核心技术人员、总经理、副总经理（离任）、实际控制人	通过景阳投资间接持有公司 19.46% 股权；通过上海骁微间接持有公司 0.01% 股权；通过上海群微间接持有公司 0.01% 股权；通过灿瑞 1 号间接持有公司 0.032% 股权	无减持	无质押或冻结
余辉	董事、副总经理、总经理（离任）	通过景阳投资间接持有公司 0.45% 股权；通过灿瑞 1 号间接持有公司 0.071% 股权	无减持	无质押或冻结
黄俊	独立董事	无	无减持	无质押或冻结
徐秀法	独立董事	无	无减持	无质押或冻结
沈美聪	董事会秘书、副总经理	通过灿瑞 1 号间接持有公司 0.024% 股权	无减持	无质押或冻结
宋烜纲	财务总监	通过灿瑞 2 号间接持有公司 0.004% 股权	无减持	无质押或冻结
林丽霞	副总经理	无	无减持	无质押或冻结
吴玉江	监事会主席、核心技术人员	通过上海群微间接持有公司 0.26% 股权；通过灿瑞 1 号间接持有公司 0.012% 股权	无减持	无质押或冻结
彭军	监事	通过上海群微间接持有公司 0.13% 股权；通过灿瑞 2 号间接持有公司 0.004% 股权	无减持	无质押或冻结
郑小明	职工监事、核心技术人员	通过上海群微间接持有公司 0.16% 股权	无减持	无质押或冻结
郎伟	核心技术人员	通过上海群微间接持有公司 0.08% 股权；通过灿瑞 2 号间接持有公司 0.005% 股权	无减持	无质押或冻结

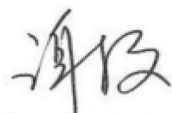
十一、 保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日，不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

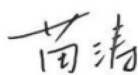
（以下无正文）

（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于上海灿瑞科技股份有限公司
2022 年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：



谢雯



苗涛

